

ICP 반응기의 입자 코팅 응용

강진이, 김교선*, 김동주

강원대학교

(kkyoseon@kangwon.ac.kr*)

플라즈마 화학 기상 증착 (PCVD) 공정은 양질의 박막을 균일하게 코팅하기 위하여 반도체 제조 공정에 널리 이용되고 있다. 본 연구에서는 회전하는 실린더형 PCVD 공정을 이용하여 TiO_2 박막을 증착하였고 공정변수에 따른 박막 특성을 분석하였다. TiO_2 박막의 전구체인 TTIP의 농도가 증가할수록 증착된 박막의 두께는 증가하였으며 반응기의 회전 속도가 빨라질수록 박막의 두께가 증가하였다.